

平成15年5月21日

各 位

会 社 名 東京応化工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 内田春彦
コード番号 4186 (東証第一部)
問 合 せ 先 総務部広報課
TEL (044) 435 - 3000

東京応化工業グループ中期計画についてのお知らせ

～第2次「tokチャレンジ21」～
(平成15年度～平成17年度)

当社は、「tokチャレンジ21」に続く、平成15年度(平成16年3月期)から平成17年度(平成18年3月期)までの中期計画を示した『第2次「tokチャレンジ21」』を策定いたしましたので、その概略についてお知らせいたします。

— 中期計画の概要 —

1. 第2次「tokチャレンジ21」中期計画策定の背景

平成12年度以降、当社は、フォトレジスト部門、とりわけ半導体フォトレジストの市場シェア奪回による業績回復に努めたものの、未曾有の世界半導体不況に見舞われる等の影響から、所期の目標に対して道半ばの状況にあります。

当社事業を取り巻く環境は、世界的な企業間競争の激化、市場ダイナミズムの加速等から、先端技術の世代交代が早まるとともに価格低下の速度が増しております。一方、製品の高機能・高性能化の要求は強まり、ニーズも複雑化しており、特に、半導体関連の技術開発は、研究開発投資の負担増大の中、短期間での投資回収が求められるなど経済的な制約が強まっています。

当社は、価値ある製品・ソリューションを提供し続けるとともに、企業価値の増大等を通じて、当社を取り巻くステークホルダーより、高い信頼と満足を寄せられるべく、今後3カ年の経営シナリオを策定いたしました。

2. 経営ビジョン

「高度な微細加工技術を必要とする各分野の先端領域」を事業領域と定め、「グローバル市場で勝ち残る企業」を目標といたします。これは、すなわち、「過去最高の利益をキャッチアップするプロセスを構築し、その後の成長ステージに歩みを進める」ことを意味しています。当社は、経営ビジョン実現の要件を以下の3点と考えています。

- (1) グローバルな市場動向を重視したアクションプランの策定と実行
- (2) コア技術の内部蓄積強化とそれに基づく独自性の発揮
- (3) 経営環境の変化に迅速且つ的確に適合可能な柔軟で強固な経営基盤

3. 基本方針

上記3つの要件を効果的・効率的に達成するため、以下の3点を軸に、事業戦略を策定し、実行することとします。

【「グローバル市場で勝ち残る企業」の実現に向けた基本方針】

(1) 微細加工技術の多角的展開

フォトポリマー技術等の微細加工技術は、当社が長年追求してきた技術であり、当社のコア・コンピタンスである。これまでに培った技術・ノウハウを如何なく発揮し、企業価値の増大に結びつけていく。

- ・既存事業の収益力強化と市場での優位性確立に向けた「微細加工技術の垂直的展開」の推進。
- ・収益源の多様化に向けた「微細加工技術の水平的展開」等の推進。既存技術・既存製品の用途開拓や新製品開発等に対する取り組みの積極化を図る。
- ・新規コア材料に係る研究開発の強化によるコア技術の内部蓄積の実現。
- ・装置メーカー、材料メーカー等とのコラボレーションの活用。
- ・材料と装置の両方を手掛けているといった当社の特長を活かした、新規用途の開拓や新製品開発等。他社材料と当社装置、当社材料と他社装置との組み合わせも視野に入れた、M&E (Materials & Equipment)の効果的な推進。

(2) 海外展開の強化

新製品の開発や製品の高度化に必要な利益を確保していく観点ならびに当社事業の成長力を高める観点から、顧客との「Face to Face」をキーワードに海外需要の獲得を進める。

- ・国内外を問わず、新工場の立ち上げをビジネスチャンスとした積極的な事業展開。
- ・海外拠点の人員・機能の充実。OAI (オーカ・アメリカ・インコーポレーテッド)、TTW (台湾東應化股份有限公司)のマーケティング拠点としての機能の強化。
- ・国内部門と海外拠点との連携強化。海外市場におけるマーケティング・開発・製造の強固な三位一体体制の構築。

(3) コスト競争力の強化

グローバル規模で製品価格の低下速度が増し、製品開発の強化だけでは、適正な利益水準の確保は難しくなっている。また、価格対応力を高めることで市場拡大に貢献し、それが企業価値の増大に繋がるものと考え、コスト競争力の強化に努める。

- ・製品の特性・規模や当社の経営資源に適した生産体制・研究開発体制の確立。

4. 各事業部門の戦略・活動方針

(1) 電子材料事業

ArFエキシマレーザー用フォトレジストなど先端材料は、付加価値が高く、拡販による売上増加、利益成長に大きく貢献できることから、その拡販を最優先課題と位置付けた事業展開を徹底する。

- ・ ArFエキシマレーザー用フォトレジスト
本格的な市場離陸時のシェア確保を重視した経営資源の優先的かつ集中的投入。
- ・ KrFエキシマレーザー用フォトレジスト
テクノロジーノード110nm以下をターゲットとした延命化ニーズをビジネスチャンスとした新規採用の獲得。

(2) ディ스플레이材料事業

薄型テレビの市場拡大を視野に入れた製品開発と価格対応力の強化を図っていく。これと同時に、台湾、韓国市場に対するマーケティングを積極的に行い、海外拡販を強力に進める。

- ・ 液晶ディスプレイ(LCD)材料
第5世代以降の新設ラインを対象に各種材料の開発と需要の獲得。
- ・ プラズマディスプレイ(PDP)材料
PDP用ドライフィルムレジスト等の開発強化及び製品拡充による市場優位性を確立。

(3) 画像材料事業

主力の感光性樹脂版は、市場の規模が大きく、成熟化が進んでいることから、価格競争力の強化を重視した販売拡大を図る。一方、レジスト材料といった独自性の高い製品については、海外市場開拓の積極化と同時にラインナップの強化を図る。

- ・ 印刷材料
一部部材の内製化等による原価低減の推進。
フレキソ印刷用感光性樹脂版のラインナップ強化と欧州販売の強化。
- ・ 回路基板材料
一部部材の内製化による原価低減の推進。
ビルドアップ基板用高追従ドライフィルムレジストの開発・製品化。
- ・ レジスト材料
実装技術の高度化・多様化に対応したパッケージ材料の拡充と海外拡販の強化。
厚膜レジスト等の新規用途の開発。

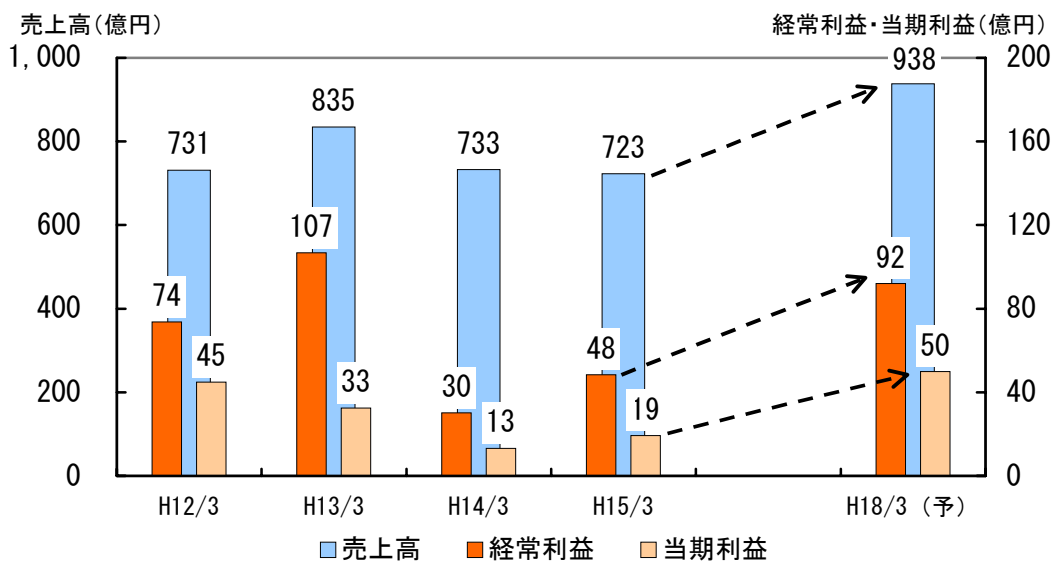
(4) 装置事業

原価管理の徹底等により利益率改善を図る。液晶ディスプレイ製造用スピンレスコーターを戦略製品と位置付けるとともに、特殊用途材料の市場開拓のためのM&Eを推進する。

- ・ 第6世代以降の大型ガラス基板対応液晶ディスプレイ製造用スピンレスコーターの早期開発と受注強化。

5. 業績予想

(1) 連結業績のこれまでの実績と最終年度の予想



(2) 連結売上高予想の事業別内訳と設備投資・減価償却・研究開発費の計画

(億円)

	平成15年3月期	平成18年3月期 (予想)	平成16年3月期～平成18年3月期累計	
売上高	723	938	設備投資	190
電子材料	384	463	減価償却費	207
ディスプレイ材料	131	191	研究開発費	206
画像材料	112	136		
装置	96	148		
海外売上比率	49%	58%		

以上

(ご注意)

上記の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。